

【28卒】夏季インターンシップ 2026

組込みソフトウェア開発

応募締切 7/05(日) ~
最終応募締切 8/16(日)

A : MESHで始めるIoT体験コース



本社・7/27(月)~7/31(金)
・8/31(月)~9/04(金)
・9/07(月)~9/11(金)

各回
30名

中部・8/03(月)~8/07(金)
・8/24(月)~8/28(金)
・9/07(月)~9/11(金)

各回
12名

B : Raspberry Piで実現するIoT開発コース

本社・8/03(月)~8/07(金)
・8/24(月)~8/28(金)

各回
30名

半導体設計

応募締切 7/20(月)

A : アナログ入門 (電子ピアノ)



・8/19(水)~8/20(木)

6名

B : アナログ回路設計

・8/24(月)~8/28(金)
・9/07(月)~9/11(金)

各回
4名

C : ロジック回路設計 (初級)

・8/17(月)~8/19(水)

6名

D : ロジック回路設計 (中級)

・8/24(月)~8/28(金)
・8/31(月)~9/04(金)
・9/07(月)~9/11(金)

各回
4名

E : ロジック回路設計 (上級1)

・8/24(月)~8/28(金)
・8/31(月)~9/04(金)
・9/07(月)~9/11(金)

各回
4名

F : ロジック回路設計 (上級2)

・8/31(月)~9/04(金)

3名

G : レイアウト設計 (初級)

・8/17(月)~8/18(火)
・8/31(月)~9/01(火)

各回
6名

H : レイアウト設計 (中級)

・9/09(水)~9/11(金)

2名

I : 半導体製造におけるデータ分析

・8/24(月)~8/25(火)
・9/07(月)~9/08(火)

各回
6名

※記載内容は変更となる場合がございます。
マイナビ2028 マイページ2028



まずは、マイナビからエントリーしてください！

問い合わせ先：東芝情報システム株式会社 インターンシップ担当

TEL : 044-210-6215 Mail : TJsaio@ml.toshiba.co.jp

TOSHIBA

東芝情報システム株式会社

【28卒】夏季インターンシップ 2026

組込みソフトウェア開発コース 全8回開催！

本社開催：【Aコース】MESHで始めるIoT体験コース

	開催期間	募集人員	応募締切
第1回	7月27日(月)～7月31日(金)	30名	7月05日(日)
第2回	8月31日(月)～9月04日(金)	30名	8月02日(日)
第3回	9月07日(月)～9月11日(金)	30名	8月16日(日)

本社開催：【Bコース】Raspberry Piで実現するIoT開発コース

	開催期間	募集人員	応募締切
第1回	8月03日(月)～8月07日(金)	30名	7月12日(日)
第2回	8月24日(月)～8月28日(金)	30名	8月02日(日)

中部支社開催：【Cコース】MESHで始めるIoT体験コース

	開催期間	募集人員	応募締切
第1回	8月03日(月)～8月07日(金)	12名	7月12日(日)
第2回	8月24日(月)～8月28日(金)	12名	8月02日(日)
第3回	9月07日(月)～9月11日(金)	12名	8月16日(日)

就業体験概要

- 会社説明：企業、事業、社風などを詳しく説明
- 開発体験：組込み開発やプログラミング、チームワークなどを体験
- 職場見学：実際に仕事をしているところを見て体感

募集要項

- 応募方法：マイナビにてエントリー後、当社マイページからご応募ください
- 選考方法：エントリーシートにて書類選考
- 対象学年：2028年3月卒業・修了予定者（学部3年生、修士1年生）
- 実施場所：本社（JR川崎駅より徒歩5分）
中部支社（地下鉄桜通線・鶴舞線 丸の内駅より徒歩2分）

- 交通費他：交通費：支給あり 食事代補助：支給あり ※必要な場合には宿泊先をご用意します

- 問い合わせ：東芝情報システム株式会社 総務部 インターンシップ担当

Tel：044-210-6215 E-mail：TJsaibo@ml.toshiba.co.jp HP：<https://www.tjsys.co.jp/>

マイナビ2028

マイページ2028

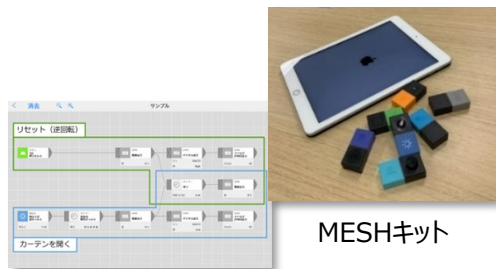


【Aコース】 MESHで始めるIoT体験コース（本社）

- ◆ ソニー製MESH™ などを利用したプロトタイプ開発
- ◆ ハッカソン、アイデアソンの手法を使った製品アイデアの創出

内容

- ・ MESHのしくみを理解
- ・ MESHで何ができるのか、チームでアイデアソンを実施
- ・ MESHを使ってアイデアを具現化
- ・ 『IT業界(組込み)』とは？業界を詳しく解説
- ・ エンベデッド事業の説明
- ・ 若手社員との対話会
- ・ 職場見学



【Bコース】 Raspberry Piで実現するIoT開発コース

- ◆ Raspberry Piを利用したプロトタイプ開発
- ◆ 複数センサを組み合わせたIoTデバイス構築
- ◆ ハッカソン、アイデアソンの手法を使った製品アイデアの創出

内容

- ・ ラズパイやセンサのしくみを理解
- ・ ラズパイで何ができるのか、チームでアイデアソンを実施
- ・ ラズパイやセンサを使ってアイデアを具現化
- ・ C言語を用いたセンサ・デバイス制御プログラミングを体験
- ・ 『IT業界(組込み)』とは？業界を詳しく解説
- ・ エンベデッド事業の説明
- ・ 若手社員との対話会
- ・ 職場見学



制御



(事例) ペットの餌やり機
Raspberry Pi 4 Model B (圧力センサ、サーボモータを組み合わせ)

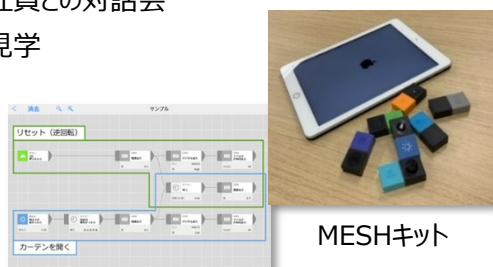
※内容は変更になることがあります。

【Cコース】 MESHで始めるIoT体験コース（中部）

- ◆ ソニー製MESH™ などを利用したプロトタイプ開発
- ◆ ハッカソン、アイデアソンの手法を使った製品アイデアの創出

内容

- ・ MESHのしくみを理解
- ・ MESHで何ができるのか、チームでアイデアソンを実施
- ・ MESHを使ってアイデアを具現化
- ・ 『IT業界(組込み)』とは？業界を詳しく解説
- ・ エンベデッド事業の説明
- ・ 若手社員との対話会
- ・ 職場見学



応募条件

- ・ 組み込みシステムに興味があること
- ・ IoTの仕事はどのようなことをやるのか知りたい方
- ・ Microsoft Office製品が使えること
- ・ [Aコース] [Cコース]
プログラミング経験は不問
- ・ [Bコース]
プログラミングの学習経験があること
(言語不問だが、C言語の経験があると望ましい)



TOSHIBA

東芝情報システム株式会社 LSIソリューション事業部(半導体設計)

【28卒】夏季インターンシップ2026

募集締切
7/20(月)

① 8月17日(月)～8月20日(木)	② 8月24日(月)～8月28日(金)
A:アナログ入門(電子ピアノ) 8/19～8/20	B:アナログ回路設計 8/24～8/28
C:ロジック回路設計(初級) 8/17～8/19	D:ロジック回路設計(中級) 8/24～8/28
	E:ロジック回路設計(上級1) 8/24～8/28
G:レイアウト設計(初級) 8/17～8/18	I:半導体製造におけるデータ分析 8/24～8/25
③ 8月31日(月)～9月4日(金)	④ 9月7日(月)～9月11日(金)
	B:アナログ回路設計 9/7～9/11
D:ロジック回路設計(中級) 8/31～9/4	D:ロジック回路設計(中級) 9/7～9/11
E:ロジック回路設計(上級1) 8/31～9/4	E:ロジック回路設計(上級1) 9/7～9/11
F:ロジック回路設計(上級2) 8/31～9/4	I:半導体製造におけるデータ分析 9/7～9/8
G:レイアウト設計(初級) 8/31～9/1	H:レイアウト設計(中級) 9/9～9/11

- 応募方法:マイナビにてエントリー後、当社マイページからご応募ください
- 選考方法:エントリーシートにて書類選考
- 対象学年:2028年3月卒業・修了予定者(学部3年生、修士1年生)
- 実施場所:本社 (JR川崎駅より徒歩5分)
- 旅費宿泊:交通費:支給あり 食事補助:支給あり ※必要な場合には宿泊先をご用意します
- お問い合わせ:東芝情報システム株式会社総務部インターンシップ担当

TEL:044-210-6215e-mail:TJsaiyo@ml.toshiba.co.jp

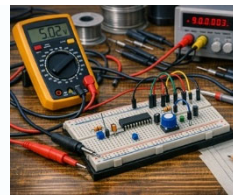
マイナビ2028

マイページ2028



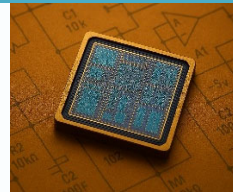
A : アナログ入門 (電子ピアノ)

- ・ ICや抵抗、コンデンサーなどを使った電子ピアノ制作を体験できます
- ・ 音の出る仕組みや電子部品について理解することができます
- ・ 初心者向けのコースなので、特別な知識がなくても大丈夫です！



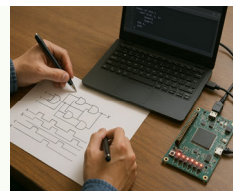
B : アナログ回路設計

- ・ 機能の検討を行い、アナログ回路を設計します
- ・ 自分で設計した回路を基板上に実装し、実際に動作を確認します



C : ロジック回路設計 (初級)

- ・ AMラジオに電波を送信する回路を設計し、FPGAで動作させます
 - ・ 仕様検討やRTL記述及び高位合成(C/C++)、検証、FPGAマッピングを行い、実際に動作を確認します
- ※ 参加条件： C言語もしくはVerilog-HDLの使用経験



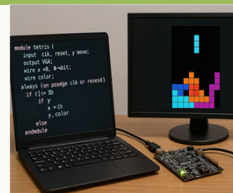
D : ロジック回路設計 (中級)

- ・ カラーバーを描画する装置を設計し、FPGAで動作させます
 - ・ 仕様検討やRTL記述及び高位合成(C/C++)、検証、FPGAマッピングを行い、実際に動作を確認します
- ※ 参加条件： C言語もしくはVerilog-HDLの使用経験



E : ロジック回路設計 (上級 1)

- ・ Verilog-HDLでゲームを作り、FPGAで動作させます
 - ・ 仕様検討やRTL設計、検証、FPGAマッピングを行い、実際に動作を確認します
- ※ 参加条件： Verilog-HDLの使用経験



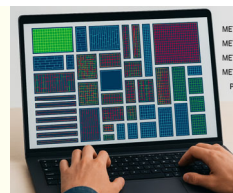
F : ロジック回路設計 (上級 2)

- ・ Verilog-HDLで簡単なCPUを設計します
 - ・ 仕様検討やRTL設計、検証を行い、シミュレーションで動作を確認します
- ※ 参加条件： Verilog-HDLの使用経験



G : レイアウト設計 (初級)

- ・ 半導体設計の最終工程である、レイアウト設計を行います
 - ・ CADを使用して、基本セルや機能ブロックのレイアウトパターンを設計します
- ※ パズルや絵を描くことが得意な方、CADを学んでいる方におススメです



H : レイアウト設計 (中級)

- ・ 半導体設計の最終工程である、レイアウト設計を行います
 - ・ 回路データを合成し、自動レイアウト、タイミング解析を行います
- ※ パズルや絵を描くことが得意な方におススメです



I : 半導体製造におけるデータ分析

- ・ 半導体製品の歩留まり(ぶどまり)を向上させるために必要なデータ分析を行います
 - ・ 歩留まりや不良解析について必要な理論と製造プロセスを解説します
- ※ 実験や数字、統計学、原因究明が好きな方向きです

